



(21) 申请号 202123330009.3

(22) 申请日 2021.12.28

(73) 专利权人 苏州勤联塑胶制品有限公司

地址 215000 江苏省苏州市相城区黄埭镇
东桥长旺路37号1号楼

(72) 发明人 董玺 沈学明

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所(普通合伙) 32246

专利代理师 张一鸣

(51) Int.Cl.

B65D 19/44 (2006.01)

B65D 19/38 (2006.01)

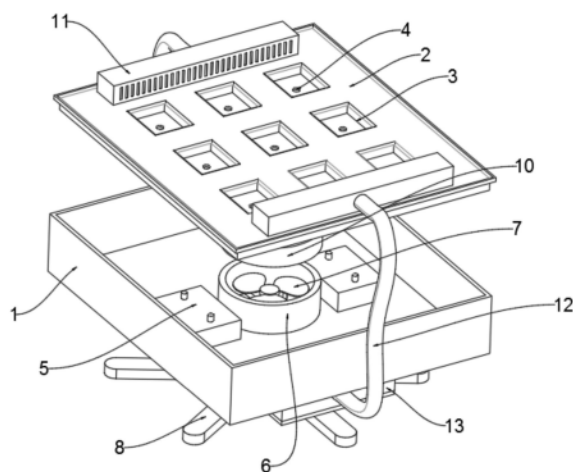
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘

(57) 摘要

本实用新型公开了新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,涉及吸塑托盘技术领域,为解决现有的吸塑托盘没有自吸结构,不能将电子芯片牢牢的吸附在吸塑托盘内,功能性和实用性均有待提高的问题。所述吸塑承托壳体的上端开口处固定安装有亚克力承托板,所述亚克力承托板的上表面上设置有多个电子芯片盛放凹槽,所述电子芯片盛放凹槽的内部端面上设置有吸气通孔,所述吸塑承托壳体下端面的中间位置处一体连接有导气支撑管,所述导气支撑管的一端延伸至吸塑承托壳体的内部,所述导气支撑管的内壁上固定连接有支架,且支架的中间位置处固定安装有吸气扇。



1. 新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,包括吸塑承托壳体(1),其特征在于:所述吸塑承托壳体(1)的上端开口处固定安装有亚克力承托板(2),所述亚克力承托板(2)的上表面上设置有多个电子芯片盛放凹槽(3),所述电子芯片盛放凹槽(3)的内部端面上设置有吸气通孔(4)。

2. 根据权利要求1所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述吸塑承托壳体(1)下端面的中间位置处一体连接有导气支撑管(6),所述导气支撑管(6)的一端延伸至吸塑承托壳体(1)的内部,所述导气支撑管(6)的内壁上固定连接有支架,且支架的中间位置处固定安装有吸气扇(7)。

3. 根据权利要求2所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述吸塑承托壳体(1)的内部端面上固定安装有蓄电池(5),所述蓄电池(5)与吸气扇(7)电性连接。

4. 根据权利要求3所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述蓄电池(5)设置有两个,且对称分布在导气支撑管(6)的两侧位置处。

5. 根据权利要求2所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述导气支撑管(6)的侧表面上设置有多个排气通槽(9)。

6. 根据权利要求2所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述导气支撑管(6)的下端固定连接有底部支撑架(8),所述底部支撑架(8)呈“米”字型。

7. 根据权利要求2所述的新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,其特征在于:所述导气支撑管(6)的外部罩扣有两个集气罩(13),所述集气罩(13)的侧表面上固定连接有导气软管(12),所述导气软管(12)的一端设置有出气罩(11),所述出气罩(11)粘连在亚克力承托板(2)的上表面上,所述导气支撑管(6)的进气端口处设置有除湿棉(10)。

新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吸塑托盘技术领域,具体为新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘。

背景技术

[0002] 吸塑托盘也叫塑料内托,采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料,将产品置于凹槽内,起到保护和美化产品的作用,也有运输型的托盘包装,托盘使用较多都是以方便为主,在电子芯片的生产过程中,需要使用吸塑托盘进行位置转移。

[0003] 现有的吸塑托盘没有自吸结构,不能将电子芯片牢牢的吸附在吸塑托盘内,功能性和实用性均有待提高;因此市场急需研制新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,以解决上述背景技术中现有的吸塑托盘没有自吸结构,不能将电子芯片牢牢的吸附在吸塑托盘内,功能性和实用性均有待提高的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,包括吸塑承托壳体,所述吸塑承托壳体的上端开口处固定安装有亚克力承托板,所述亚克力承托板的上表面上设置有多个电子芯片盛放凹槽,所述电子芯片盛放凹槽的内部端面上设置有吸气通孔。

[0006] 优选的,所述吸塑承托壳体下端面的中间位置处一体连接有导气支撑管,所述导气支撑管的一端延伸至吸塑承托壳体的内部,所述导气支撑管的内壁上固定连接有支架,且支架的中间位置处固定安装有吸气扇。

[0007] 优选的,所述吸塑承托壳体的内部端面上固定安装有蓄电池,所述蓄电池与吸气扇电性连接。

[0008] 优选的,所述蓄电池设置有两个,且对称分布在导气支撑管的两侧位置处。

[0009] 优选的,所述导气支撑管的侧表面上设置有多个排气通槽。

[0010] 优选的,所述导气支撑管的下端固定连接有底部支撑架,所述底部支撑架呈“米”字型。

[0011] 优选的,所述导气支撑管的外部罩扣有两个集气罩,所述集气罩的侧表面上固定连接有导气软管,所述导气软管的一端设置有出气罩,所述出气罩粘连在亚克力承托板的上表面上,所述导气支撑管的进气端口处设置有除湿棉。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 1、该实用新型通过在吸塑承托壳体的上端开口处固定安装亚克力承托板,亚克力承托板的上表面上设置有多个电子芯片盛放凹槽,电子芯片盛放凹槽的内部端面上设置有吸气通孔,此举可以利用亚克力承托板上的电子芯片盛放凹槽来对电子芯片进行限位盛放,此时亚克力承托板能有效的适应外部的高温环境,能有效的提高整个吸塑托盘的耐高

温性能,以及在承托转运的过程中,使得吸气通孔处产生吸力,进而能将电子芯片紧紧的吸附在电子芯片盛放凹槽的底部端面上,对电子芯片进行了有效的限位操作,从而使得该吸塑托盘具备电子芯片限位紧固结构,能有效的提高电子芯片在位置转移过程中的稳定性,有效的提高了该吸塑托盘的功能性和实用性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体示意图;

[0015] 图2为本实用新型的整体底部示意图;

[0016] 图3为本实用新型的主视图。

[0017] 图中:1、吸塑承托壳体;2、亚克力承托板;3、电子芯片盛放凹槽;4、吸气通孔;5、蓄电池;6、导气支撑管;7、吸气扇;8、底部支撑架;9、排气通槽;10、除湿棉;11、出气罩;12、导气软管;13、集气罩。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3,本实用新型提供了一种实施例:新型耐高温EPP电子芯片吸塑托盘,包括吸塑承托壳体1,吸塑承托壳体1的上端开口处固定安装有亚克力承托板2,亚克力承托板2的上表面上设置有多电子芯片盛放凹槽3,电子芯片盛放凹槽3的内部端面上设置有吸气通孔4,此举可以利用亚克力承托板2上的电子芯片盛放凹槽3来对电子芯片进行限位盛放,此时亚克力承托板2能有效的适应外部的高温环境,能有效的提高整个吸塑托盘的耐高温性能,以及在承托转运的过程中,使得吸气通孔4处产生吸力,进而能将电子芯片紧紧的吸附在电子芯片盛放凹槽3的底部端面上,对电子芯片进行了有效的限位操作,从而使得该吸塑托盘具备电子芯片限位紧固结构,能有效的提高电子芯片在位置转移过程中的稳定性,有效的提高了该吸塑托盘的功能性和实用性。

[0020] 进一步,吸塑承托壳体1下端面的中间位置处一体连接有导气支撑管6,导气支撑管6的一端延伸至吸塑承托壳体1的内部,导气支撑管6的内壁上固定连接有支架,且支架的中间位置处固定安装有吸气扇7,吸塑承托壳体1的内部端面上固定安装有蓄电池5,蓄电池5与吸气扇7电性连接,蓄电池5设置有两个,且对称分布在导气支撑管6的两侧位置处,导气支撑管6的侧表面上设置有多排气通槽9。

[0021] 进一步,导气支撑管6的下端固定连接有底部支撑架8,底部支撑架8呈“米”字型。

[0022] 进一步,导气支撑管6的外部罩扣有两个集气罩13,集气罩13的侧表面上固定连接有导气软管12,导气软管12的一端设置有出气罩11,出气罩11粘连在亚克力承托板2的上表面上,导气支撑管6的进气端口处设置有除湿棉10。

[0023] 工作原理:使用时,将电子芯片放置在电子芯片盛放凹槽3的内部,此时利用亚克力承托板2来接触高温电子芯片,亚克力材质具备较高的耐高温性能,因此能有效的提高该吸塑托盘的耐高温性能,然后启动吸气扇7,在吸气扇7的转动下,外部的空气从吸气通孔4处进入吸塑承托壳体1的内部,经过除湿棉10的除湿操作后,然后再从导气支撑管6侧表面

上的排气通槽9排至集气罩13的内部,接着经过导气软管12的引导后进入出气罩11的内部,然后排出,并对电子芯片进行表面除湿操作,使其具备除湿功能,同时吸气通孔4处具备较强的吸力,能将电子芯片牢牢的吸附在电子芯片盛放凹槽3的内部端面上,进而便于该吸塑托盘在转运过程中电子芯片位置的稳定性,在该吸塑托盘使用的过程中,蓄电池5能为吸气扇7提供需要的电能。

[0024] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

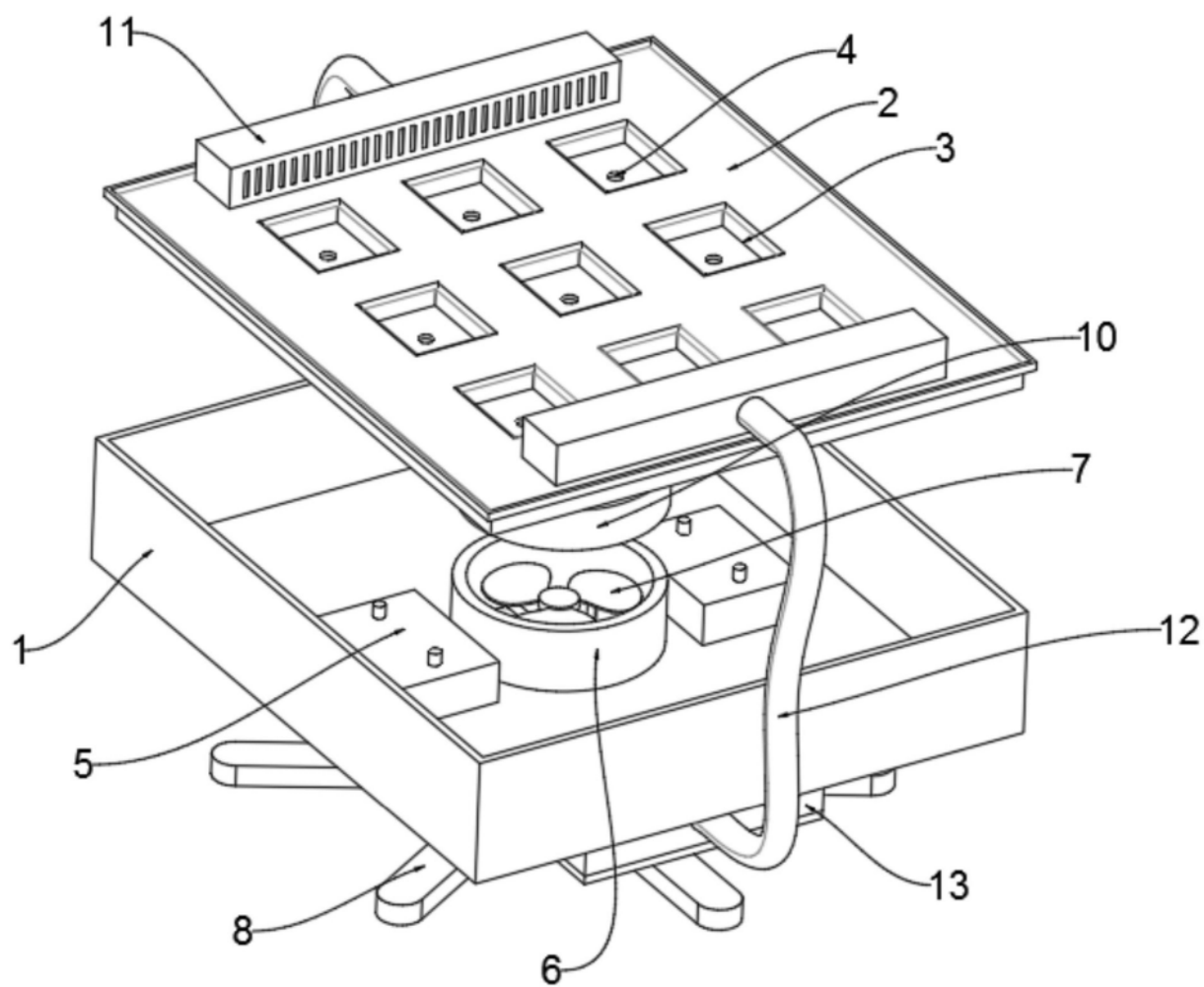


图1

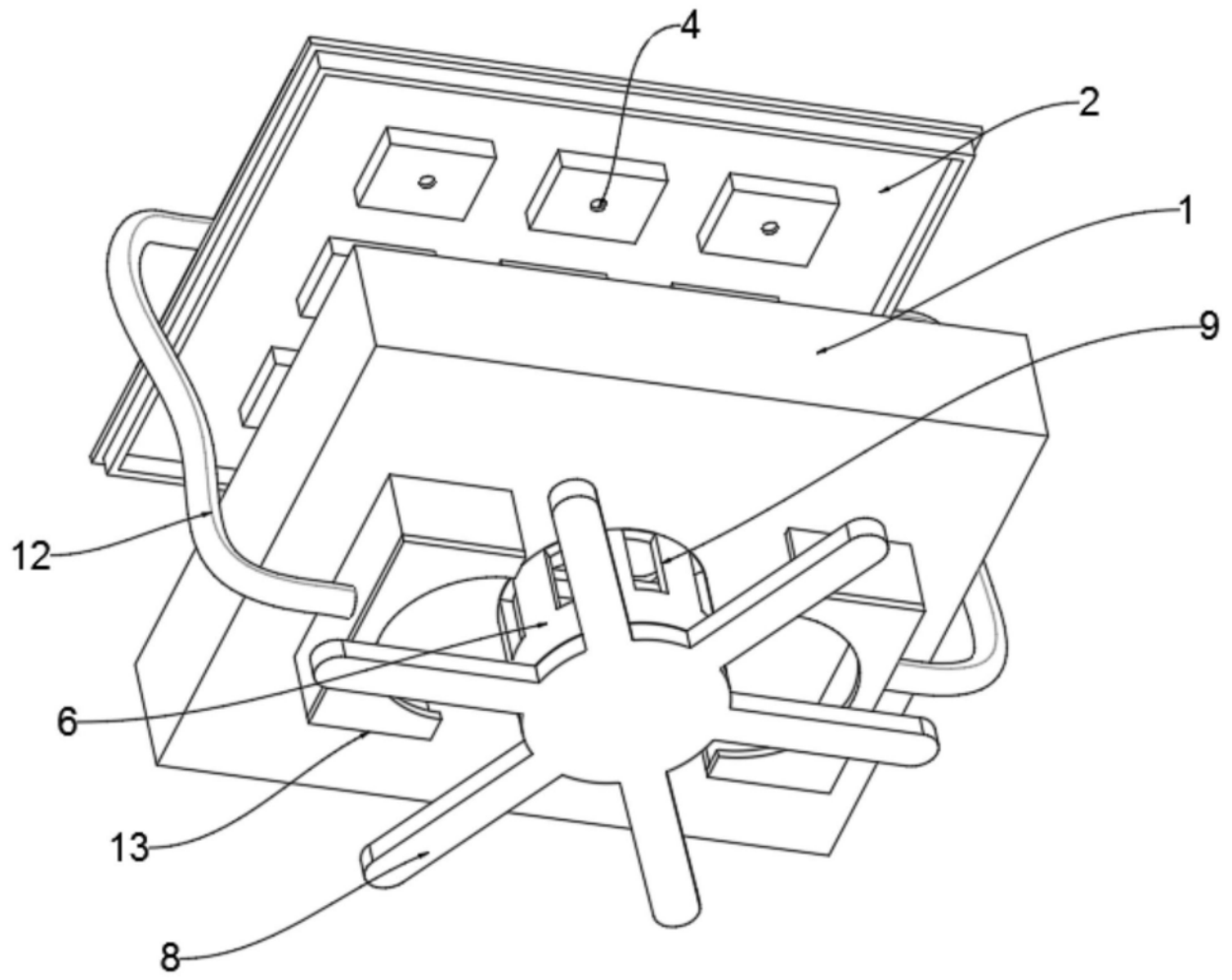


图2

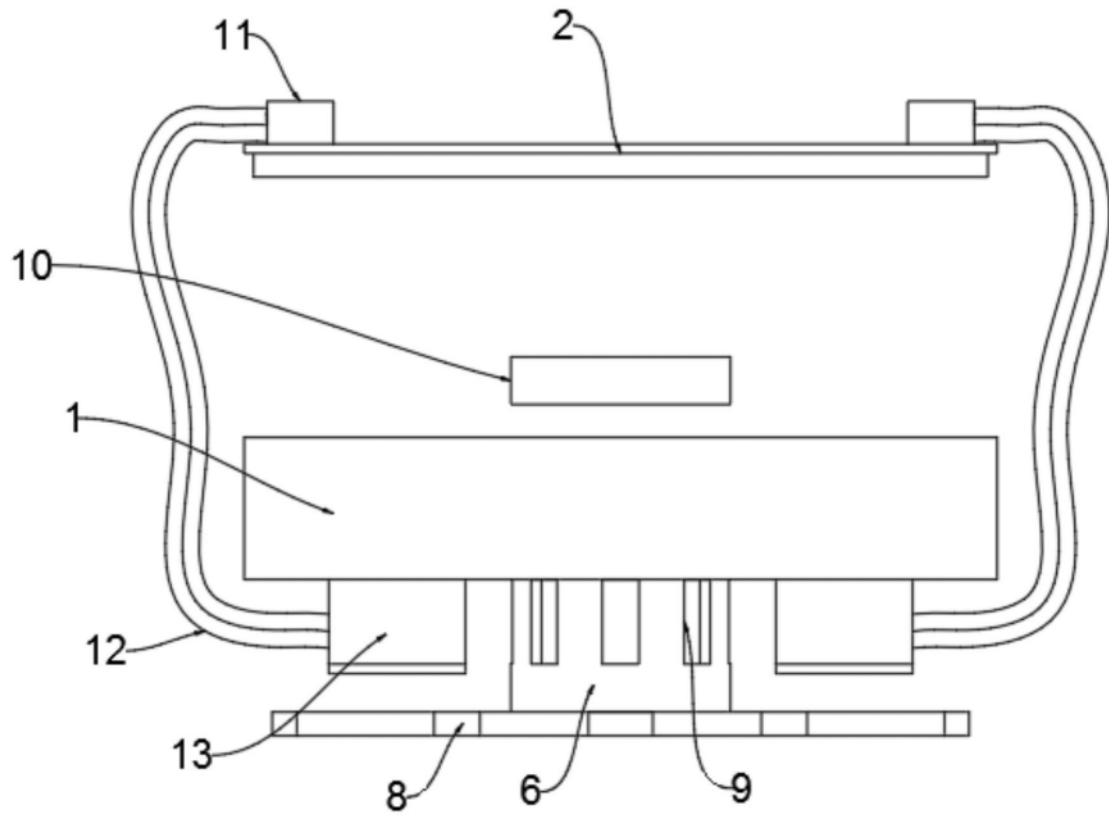


图3